

中国物联网芯片行业现状深度分析与发展前景研究报告（2024-2031年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国物联网芯片行业现状深度分析与发展前景研究报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202410/732381.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

1、物联网芯片概述

物联网芯片是一种嵌入式芯片，具备无线通信和数据处理能力，能够接收传感器或其他设备采集的数据，并通过无线网络与其他设备进行数据传输和交互。它是实现物联网应用中的通信、计算和控制功能的核心部件。

物联网芯片主要特点

资料来源：观研天下整理

2、市场与政策的加持，驱动我国物联网芯片行业发展

我国是物联网技术应用的巨大市场。根据工信部数据，截至2024年7月末，全国移动通信基站总数达1193万个；截至2024年7月末，基础电信企业发展移动物联网终端用户数达25.47亿户，占移动终端连接数比重达到59%。

数据来源：观研天下整理

与此同时，2024年8月，工业和信息化部办公厅印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，通知表示到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G（含NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5GNB-IoT网络实现重点场景深度覆盖。5GRedCap实现全国县级以上城市规模覆盖，并向重点乡镇、农村延伸覆盖。移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。支持全国建设5个以上移动物联网产业集群，打造10个以上移动物联网产业示范基地。培育一批亿级连接的应用领域，打造一批千万级连接的应用领域。

3、我国物联网行业取得显著发展，物联网芯片迎来无限商机

因此，在上述因素驱动下，我国物联网行业取得了显著的发展，我国成为全球物联网主要市场之一，而物联网市场的增长让物联网芯片迎来无限商机。2020年我国物联网设备连接量达74亿台，占全球物联网设备连接量的65.49%，预计2025年设备连接量达150亿台，占全球物联网设备连接量的67.57%；2022-2024年我国物联网市场规模有望由3.05万亿元增长到4.31万亿元，预计2028年我国物联网市场规模将达6.09万亿元。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

4、5G、人工智能等技术普及让物联网芯片的出货量进一步增加

从需求方面来分析，5G、人工智能等技术普及让物联网芯片行业出货量进一步增加。

随着物联网逐渐渗透到公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域，促进产业生态不断壮大，形成涵盖芯片、模组、终端、设备、服务等环节的完整移动物联网产业链。而链接是物联网相关芯片产业链中一个很重要的因素，涉及相当多的通信协议。每款协议标准的升级迭代速度较快，无线物联网芯片设计企业必须针对标准演进不断迭代产品。

而2018年6月，3GPP 5G NR标准独立组网（SA，Standalone）方案在3GPP第80次TSG RAN全会正式完成并发布，标志着第一份国际5G标准正式出炉，此后全球各地陆续开始了5G的商业化应用。5G的使用不仅带来更高速率、更低延时、更大连接的移动通信，并且5G标准下移动通信的业务覆盖对象从手机扩展到更多的IoT设备，从人与人之间的通信走向人与人、物与物之间的通信，这也为物联网芯片行业带来巨大需求潜力。

每代移动通信特征

移动通信

1G

2G

3G

4G

5G

业务

电路域模拟话音业务

数字语音，短信，9.6-384kbit/s数据业务

话音、短信和多媒体

全IP移动宽带数据业务，VoIP

增强移动宽带，超高可靠低延时通信和机器类通信

目标

提高单站话音路数和频谱效率

提高频谱效率，无缝切换

高速移动144kbit/s，低速移动2Mbit/s：后续支持40Mbit/s以上速率

低速1Gbit/s,高速100Mbit/s，频谱效率和用户体验极大提升

峰值速率10-20Gbit/s，支持500km/h高速移动，百万连接/平方公里的设备连接能力等
关键技术

FDMA，模拟调制，基于蜂窝结构的频率复用

TDMA/CDMA，GMSK/QPSK数字调制，无缝切换，漫游

CDMA，分组交换：演进引入HARQ和AMC，动态调度，MIMO以及高阶调制

OFDM，MIMO，高阶调制，链路自适应，全IP核心网，扁平网络架构

模块化网络，云化组网，边缘计算，短帧，快速反馈，多层/多站数据重传

频率

800/900MHz

800/900MHz, 1800MHz

2GHz频段为主, 也支持800/900MHz、1800MHz

广泛的支持所有ITU分配的移动通信频谱, 范围从450MHz到3.8GHz

450MHz到5GHz

覆盖

宏覆盖, 小区半径千米量级

宏小区/微小区为主, 小区半径几百米到几千米

宏小区/微小区/皮小区, 小区半径几十米、几百米到几千米

宏小区/微小区/皮小区/家庭基站, 小区半径十几米、几百米到几千米

小区半径进一步缩短

商用周期

1980-2000年

1992年至今

2001年至今

2010年至今

2020年至今

资料来源: 观研天下整理

也就是说, 谁能“签上”新协议, 谁就有机会把握市场的主动权。举例, 传统陆地移动通信服务仅覆盖不足6%的地表面积, 而卫星互联网可以实现全球覆盖, 为偏远区域、海洋等提供网络补充, 在应急通信、公共安全等特定场景能有效解决无基站区域的通信需求, 这都对物联网芯片行业及运营商都提出新要求。

5、芯片公司加码物联网, 行业国产化进程加快

目前, 我国物联网芯片行业仍被国外企业占据主导。但是, 由于应用场景不断拓展、政策支持力度加大以及需求潜力持续释放, 吸引各大芯片公司加码物联网, 行业也正在等待国产芯片公司的发力与突破。

我国芯片企业加码物联网相关情况

企业名称

进展

卓胜微

主要产品为射频前端分立器件和射频模组产品, 主要应用于智能手机等移动智能终端产品、智能穿戴、通信基站、汽车电子、蓝牙耳机、VR/AR设备及网通组网设备等需要无线连接的领域。公司低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于智能家居、可穿戴设备等电子产品。卓胜微预计, 随着5G渗透率的提升及国产替代的趋势, 其射频前端芯片市场将继续增长。公司在射频模组和分立器件方面的竞争力将进一步提升。

泰凌微

公告称经财务部门初步测算，预计公司2024年前三季度实现营业收入58,628.60万元左右，与上年同期相比，将增加11,016.28万元，同比增加约23.14%。泰凌微的主要业务是低功耗无线物联网芯片的研发、设计与销售，主要聚焦于低功耗蓝牙芯片、多协议（含Zigbee、Matter等）物联网芯片、私有协议2.4G芯片和无线音频芯片等产品。对于业绩增长，泰凌微表示公司产品在各个物联网细分市场持续取得进展，例如智能家居、商用智能照明市场，通过加强与谷歌、亚马逊等大型互联网生态企业的合作，公司芯片被其生态链重要合作伙伴所采用，实现了大批量的出货。

资料来源：观研天下整理（WYD）

注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国物联网芯片行业现状深度分析与发展前景研究报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国物联网芯片行业发展概述

第一节 物联网芯片行业发展情况概述

一、物联网芯片行业相关定义

二、物联网芯片特点分析

三、物联网芯片行业基本情况介绍

四、物联网芯片行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、物联网芯片行业需求主体分析

第二节中国物联网芯片行业生命周期分析

一、物联网芯片行业生命周期理论概述

二、物联网芯片行业所属的生命周期分析

第三节物联网芯片行业经济指标分析

一、物联网芯片行业的赢利性分析

二、物联网芯片行业的经济周期分析

三、物联网芯片行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球物联网芯片行业市场发展现状分析

第一节全球物联网芯片行业发展历程回顾

第二节全球物联网芯片行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲物联网芯片行业地区市场分析

一、亚洲物联网芯片行业市场现状分析

二、亚洲物联网芯片行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲物联网芯片行业市场前景分析

第四节北美物联网芯片行业地区市场分析

一、北美物联网芯片行业市场现状分析

二、北美物联网芯片行业市场规模与市场需求分析

三、北美物联网芯片行业市场前景分析

第五节欧洲物联网芯片行业地区市场分析

一、欧洲物联网芯片行业市场现状分析

二、欧洲物联网芯片行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲物联网芯片行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界物联网芯片行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球物联网芯片行业市场规模预测

第三章 中国物联网芯片行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对物联网芯片行业的影响分析

第三节中国物联网芯片行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对物联网芯片行业的影响分析

第五节中国物联网芯片行业产业社会环境分析

第四章 中国物联网芯片行业运行情况

第一节中国物联网芯片行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国物联网芯片行业市场规模分析

一、影响中国物联网芯片行业市场规模的因素

二、中国物联网芯片行业市场规模

三、中国物联网芯片行业市场规模解析

第三节中国物联网芯片行业供应情况分析

一、中国物联网芯片行业供应规模

二、中国物联网芯片行业供应特点

第四节中国物联网芯片行业需求情况分析

一、中国物联网芯片行业需求规模

二、中国物联网芯片行业需求特点

第五节中国物联网芯片行业供需平衡分析

第五章 中国物联网芯片行业产业链和细分市场分析

第一节中国物联网芯片行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、物联网芯片行业产业链图解

第二节中国物联网芯片行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对物联网芯片行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对物联网芯片行业的影响分析

第三节我国物联网芯片行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国物联网芯片行业市场竞争分析

第一节 中国物联网芯片行业竞争现状分析

一、中国物联网芯片行业竞争格局分析

二、中国物联网芯片行业主要品牌分析

第二节 中国物联网芯片行业集中度分析

一、中国物联网芯片行业市场集中度影响因素分析

二、中国物联网芯片行业市场集中度分析

第三节 中国物联网芯片行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国物联网芯片行业模型分析

第一节 中国物联网芯片行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国物联网芯片行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国物联网芯片行业SWOT分析结论

第三节 中国物联网芯片行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国物联网芯片行业需求特点与动态分析

第一节中国物联网芯片行业市场动态情况

第二节中国物联网芯片行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节物联网芯片行业成本结构分析

第四节物联网芯片行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国物联网芯片行业价格现状分析

第六节中国物联网芯片行业平均价格走势预测

一、中国物联网芯片行业平均价格趋势分析

二、中国物联网芯片行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国物联网芯片行业所属行业运行数据监测

第一节中国物联网芯片行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国物联网芯片行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国物联网芯片行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国物联网芯片行业区域市场现状分析

第一节 中国物联网芯片行业区域市场规模分析

一、影响物联网芯片行业区域市场分布的因素

二、中国物联网芯片行业区域市场分布

第二节 中国华东地区物联网芯片行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区物联网芯片行业市场分析

（1）华东地区物联网芯片行业市场规模

（2）华东地区物联网芯片行业市场现状

（3）华东地区物联网芯片行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区物联网芯片行业市场分析

（1）华中地区物联网芯片行业市场规模

（2）华中地区物联网芯片行业市场现状

（3）华中地区物联网芯片行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区物联网芯片行业市场分析

（1）华南地区物联网芯片行业市场规模

（2）华南地区物联网芯片行业市场现状

（3）华南地区物联网芯片行业市场规模预测

第五节 华北地区物联网芯片行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区物联网芯片行业市场分析

（1）华北地区物联网芯片行业市场规模

（2）华北地区物联网芯片行业市场现状

（3）华北地区物联网芯片行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区物联网芯片行业市场分析

- (1) 东北地区物联网芯片行业市场规模
- (2) 东北地区物联网芯片行业市场现状
- (3) 东北地区物联网芯片行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

- 一、西南地区概述
- 二、西南地区经济环境分析
- 三、西南地区物联网芯片行业市场分析
 - (1) 西南地区物联网芯片行业市场规模
 - (2) 西南地区物联网芯片行业市场现状
 - (3) 西南地区物联网芯片行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

- 一、西北地区概述
- 二、西北地区经济环境分析
- 三、西北地区物联网芯片行业市场分析
 - (1) 西北地区物联网芯片行业市场规模
 - (2) 西北地区物联网芯片行业市场现状
 - (3) 西北地区物联网芯片行业市场规模预测

第十一章 物联网芯片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析
 - 5、企业成长能力分析
- 四、公司优势分析

第二节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第三节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第四节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第五节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第六节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第七节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第八节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第九节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国物联网芯片行业发展前景分析与预测

第一节 中国物联网芯片行业未来发展前景分析

- 一、物联网芯片行业国内投资环境分析
- 二、中国物联网芯片行业市场机会分析
- 三、中国物联网芯片行业投资增速预测

第二节 中国物联网芯片行业未来发展趋势预测

第三节 中国物联网芯片行业规模发展预测

- 一、中国物联网芯片行业市场规模预测
- 二、中国物联网芯片行业市场规模增速预测
- 三、中国物联网芯片行业产值规模预测
- 四、中国物联网芯片行业产值增速预测
- 五、中国物联网芯片行业供需情况预测

第四节 中国物联网芯片行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国物联网芯片行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国物联网芯片行业进入壁垒分析

- 一、物联网芯片行业资金壁垒分析
- 二、物联网芯片行业技术壁垒分析
- 三、物联网芯片行业人才壁垒分析
- 四、物联网芯片行业品牌壁垒分析
- 五、物联网芯片行业其他壁垒分析

第二节 物联网芯片行业风险分析

- 一、物联网芯片行业宏观环境风险
- 二、物联网芯片行业技术风险
- 三、物联网芯片行业竞争风险
- 四、物联网芯片行业其他风险

第三节 中国物联网芯片行业存在的问题

第四节 中国物联网芯片行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国物联网芯片行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国物联网芯片行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国物联网芯片行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节物联网芯片行业营销策略分析

一、物联网芯片行业产品策略

二、物联网芯片行业定价策略

三、物联网芯片行业渠道策略

四、物联网芯片行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202410/732381.html>